(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-40227

(43)公開日 平成11年(1999)2月12日

(51) Int.Cl. 6		識別記号	FΙ		
H01R	11/01		H01R	11/01	K
	23/68	303		23/68	303E
H05K	1/14		H05K	1/14	J

審査請求 有 請求項の数12 FD (全 8 頁)

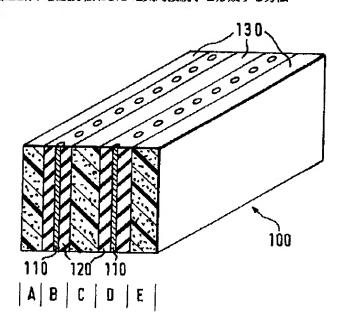
(21)出願番号	特顧平10-204304	(71)出願人	398038580
			ヒューレット・パッカード・カンパニー
(22)出願日	平成10年(1998)7月3日		HEWLETT-PACKARD COM
			PANY
(31)優先権主張番号	97111370. 9		アメリカ合衆国カリフォルニア州パロアル
(32)優先日	1997年7月4日		ト ハノーバー・ストリート 3000
(33)優先権主張国	ドイツ (DE)	(72)発明者	マルクス・ミュラー
			ドイツ ジンデルフィンゲン プラントシ
			ュトラーセ 10
		(72)発明者	ロルフ・ノイパイラー
			ドイツ マクスタット フェルトベルクシ
			ュトラーセ 27
		(74)代理人	弁理士 上野 英夫

(54) 【発明の名称】 エラストマ接続子、接続装置、機械的組立体、接続方法および電気的接続子を形成する方法

(57)【要約】

【課題】製造しやすく精度が高い圧縮性エラストマ接続 子を提供する。

【解決手段】モジュール間に電気的接続を与えるための エラストマ接続子は、強化材の中に埋め込まれた一つ以 上の (接続用) 導電要素を有する安定化ユニットを備 え、該安定化ユニットは圧縮性材料の中に埋め込まれて いる。一実施例では、圧縮性材料の複数の圧縮性層、お よび各々が少なくとも一つの埋め込み導電要素を備えた 強化材の複数の接続層を備え、複数の接続層の各一つが 圧縮性層間に設置されるようになっている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】電気的接続を与えるエラストマ接続子であ って、強化材に埋め込まれた一つ以上の導電要素を有す る安定化ユニットを備え、安定化ユニットを圧縮性材料 に埋め込んだことを特徴とするエラストマ接続子。

【請求項2】電気的接続を与えるエラストマ接続子であ って、圧縮性材料の第1の層、複数の埋め込み導電要素 の第1の列を有する強化材の第2の層、圧縮性材料の第 3の層、複数の埋め込み導電要素の第2の列を有する強 化材の第4の層、および圧縮性材料の第5の層、から成 10 る構成を備えていることを特徴とするエラストマ接続 子。

【請求項3】圧縮性材料の複数の圧縮性層、および各々 が少なくとも一つの埋め込み導電要素を有する強化材の 複数の接続層を備え、複数の接続層の各々を隣接する圧 縮性層間に配置することを特徴とするエラストマ接続 子。

【請求項4】第1のモジュールと第2のモジュールとの 間に電気的接続を与える接続装置であって、圧縮性エラ ストマ接続子、およびエラストマ接続子を位置決めする ための位置決め枠を備えているものにおいて、

エラストマ接続子は、請求項1~請求項3のいずれか一 つに従って構成され、

位置決め枠の内部寸法は、エラストマ接続子の外部寸法 と実質的に同じであり、

エラストマ接続子の高さは、位置決め枠の高さより少な くともわずか大きいことを特徴とする接続装置。

【請求項5】位置決め枠は熱伝導性の高い材料から作ら れていることを特徴とする請求項4記載の接続装置。

【請求項6】更に、位置決め枠を位置決めするための少 なくとも一つの位置決め手段を備えていることを特徴と する請求項4または請求項5のいずれかに記載の接続装 置。

【請求項7】複数の電子モジュールを接続させるための 機械的組立体であって、複数の電子モジュールの隣接モ ジュール間に設置された、請求項4または請求項5に従 って構成された接続装置を備えていることを特徴とする 機械的組立体。

【請求項8】複数の電子モジュールを接続させるため請 求項1または請求項2に記載のエラストマ接続子を使用 することを特徴とする接続方法。

【請求項9】複数の電子モジュールを接続させるため請 求項4または請求項5に記載の接続装置を使用すること を特徴とする接続方法。

【請求項10】複数の電子モジュールを接続させるのに 請求項4または請求項5に記載の機械的組立体を使用す ることを特徴とする接続方法。

【請求項11】電気的接続子を形成する方法であって、 一つ以上の導電要素を強化材に埋め込み、安定化ユ ニットを構成するステップ、および

2 b 前記安定化ユニットを圧縮性材料に埋め込むステッ プ、から成ることを特徴とする方法。

【請求項12】電気的接続子を形成する方法であって. 圧縮性材料の第1の層を設けるステップ、

複数の埋め込み導電要素の第1の列を有する強化材の第 2の層を設けるステップ、

圧縮性材料の第3の層を設けるステップ、

複数の埋め込み導電要素の第2の列を有する強化材の第 4の層を設けるステップ、および圧縮性材料の第5の層 を設けるステップ、から成ることを特徴とする方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、一般にエラストマ 接続子等の電気的接続子に関し、特に複数の電子モジュ ールを接続させるための接続装置および機械的組立体に 関する。

[0002]

【従来の技術】複数の電子モジュールおよびPC板(印 刷配線板)を備えた(したがって多数の電気接続子を備 えた)複雑な電子システムにおいては、これらモジュー ルおよびPC板の機械的および電子的組立が益々重要に なってきている。これは、一方において、益々複雑にな る集積構造および組立空間の制約のためであり、他方に おいて、電子システムに関わる熱および冷却の問題のた めである。更に、モジュール式組立が望まれている。

【0003】エラストマ材料により与えられる電気的接 続子(エラストマ接続子)はしばしば、着脱可能接続を 達成するのに使用されている。欧州特許出願公開第023 8 410号明細書および欧州特許出願公開第0 558 855号明 細書には、弾性接続を与えるためにこのようなエラスト マ接続子を使用する装置が開示されている。

【0004】図1は、業界で既知のエラストマ接続子10 の主要構造を示している。エラストマ接続子10は、一般 に金属またはカーボンのワイヤまたはファイバなどの導 電要素20、およびシリコーンゴムのような弾性支持体30 から成り、導電要素20が通常弾性支持体30に埋め込まれ ている導電性の接続媒体である。

【0005】たとえば、第1のPC板40と第2のPC板 50との間にエラストマ接続子10を押し当てることによ り、エラストマ接続子10の隣接する面に圧力を加えるこ とにより、支持材30は弾性的に変形し、導電要素20は、 第1および第2のPC板40および50の対応する接触域と 接触し、したがって第1のPC板40と第2のPC板50と の間に電気的(および機械的)接続が確立する。弾性支 持体30の中にある導電要素20を、たとえば、(図1に示 したように)列を成して、またはまたは他の所要の順序 に設置することができる。

【0006】固体絶縁シリコーンゴムを主体とする多様 なエラストマ接続子10が日本の信越ポリマ株式会社によ 50 りGB型インターコネクタとして供給されている。小ピ

ッチのPC板を接続する場合には、日本の信越ポリマ株式会社によりGN型インターコネクタとして供給されているような、絶縁スポンジゴムを支持用固体ゴムに適用することができる。

【0007】英国特許第2 269 061号明細書および米国特許第4,201,435号明細書には、各々が弾性材料内に埋め込まれた導電要素を有するユニットを備えたエラストマ接続子を備えている。国際公開第96/22621号パンフレットには、導電要素が強化材の中に部分的に埋め込まれているユニットが開示されている。このユニットは更に、柔軟な弾力性材料の中に埋め込まれている。他のエラストマ接続子は、米国特許第5,500,280号明細書および英国特許第2 054 284号明細書に開示されている。

【0008】図1に示したような接続を確立しようとす るとき、業界で知られているようにこれらエラストマ接 統子10には限られた量の圧力だけを加えることができる ことが見いだされている。これは弾性支持体30の弾性的 性質のためである。すなわち、エラストマ接続子10は圧 力を加えられたとき「流れる」傾向があり、これはエラ ストマ接続子10が圧力の影響を受けてその内部および外 部の形状および横寸法を変化するということを意味す る。特にエラストマ接続子10が導電要素20の複数の列か ら構成されているときは、個別導電要素20により与えら れるエラストマ接続子10の接触域の位置が変わることが ある。これにより、接触させようとするそれぞれの接触 域、たとえば、第1および第2のPC板40および50に対 するエラストマ接続子10の接触域の、位置の不整合を生 じ、したがって高い接触抵抗、または接触が行なわれな いというような、接触欠陥を生ずる可能性がある。更 に、エラストマ接続子10は一般に、その熱伝導度が低い ため、接続されるモジュールの間の熱接続を不能として いる。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】英国特許第2 276 502 号明細書には、絶縁弾性シートの三つの水平層に埋め込まれた垂直導電要素を備え、それにより圧縮性発泡合成樹脂材料から形成された層が弾力性の非発泡合成樹脂材料から形成された二つの隣接層の間に設けられる異方性導電性弾性コネクタを開示している。英国特許第2 276 502号明細書には、上述の短所を克服し、「流れ」の問題を解決している装置例が開示されている。しかし、この装置の短所は、この装置が、たとえば、導電要素を、製造プロセス中、すべての層が順次に形成されてしまうまで整列したままにしておかなければならないから、製造が困難であるということである。

【0010】したがって本発明の目的は、製造しやすい 圧縮性エラストマ接続子を提供することである。

【0011】上に指摘したように、エラストマ接続子は しばしば、電子モジュール間に電気的接続を与える接続 装置に適用される。英国特許第2 276 502号明細書には 更に、配線板とICパッケージとの間に電気的接続を与える接続装置を開示している。この装置は、上述のエラストマ接続子およびエラストマ接続子を位置決めするためのコネクタ枠を備えている。

4

【0012】本発明の更に他の目的は、電子モジュール間に電気的接続を与える他の接続装置を提供することである。

[0013]

【課題を解決するための手段】本発明の第1の態様によ 10 る、電気的接続を与えるためのエラストマ接続子は、強 化材の中に埋め込まれた一つ以上の導電要素を有する安 定化ユニットを備えている。安定化ユニットは、これも 圧縮性材料の中に埋め込まれている。

【0014】本発明の第2の態様によるエラストマ接続子は、圧縮性材料の複数の圧縮性層、および各々が少なくとも一つの埋め込み導電要素を備えた、強化材の複数の接続層を備え、それにより、複数の接続層の各一つが圧縮性層の隣接層の間に設置されるようになっている。

【0015】本発明によるエラストマ接続子では、圧縮性材料は、圧力の影響を受けて圧縮される。エラストマ接続子内部での圧縮性材料と強化材との構成により、強化材の、したがって導電要素の、圧力の影響下での「流れ」は、極小の程度にまで減少する。強化材の隣接層が圧縮性材料の1層により分離されている複数の個別層から成る構成を選択する場合には、個別の1層または強化材の「流れ」は、強化材の次の層に影響しないか、または極小程度に影響するだけである。

【0016】本発明によるエラストマ接続子はしたがって、エラストマ接続子に加えられる圧力の量を増大させることができる。接触させようとするそれぞれの接触域に対するエラストマ接続子の接触域の位置の不整合は、防止される。

【0017】第1のモジュールと第2のモジュールとの間の電気的接続を与えるための、本発明の第3の態様による接続装置は、第1および第2の態様による圧縮性エラストマ接続子、およびエラストマ接続子を位置決めするための位置決め枠を備えている。位置決め枠の内部寸法は、エラストマ接続子の外部寸法と実質的に同じであり、エラストマ接続子の高さは、位置決め枠の高さより40少なくともわずかに大きい。

【0018】接続装置は、エラストマ接続子の容易で精密な位置決めを可能とする。更に、接続装置をモジュール間で押圧したとき、および特に位置決め枠を熱伝導度の高い材料として設けると、接続させようとするモジュール間の熱接続を改善することができる。

【0019】複数の電子モジュールを接続させるための、本発明の第4の態様による機械的組立体は、複数の電子モジュールの隣接モジュール間に設置された、第3の態様による接続装置を備えている。

【0020】機械的組立体は、接続させようとする複数

 $\overline{}$

のモジュールの取り扱いおよび接続を容易にし、大量の モジュールに拡張することができ、一般に機械的公差の ような制約により制限されるだけである。機械的組立体 全体は、接続させようとするモジュールの数に関係なく 唯一つの機械的組立体を表す。

【0021】本発明の第1の態様による電気的接続を与 える方法は、一つ以上の導電要素を強化材に埋め込み、 安定化ユニットを形成するステップ、および安定化ユニ ットを圧縮性材料に埋め込むステップから成る。

【0022】本発明による電気的接続を与える方法は、 圧縮性材料の第1の層を設けるステップ、複数の埋め込 み導電要素の第1の列を有する強化材の第2の層を設け るステップ、圧縮性材料の第3の層を設けるステップ、 複数の埋め込み導電要素の第2の列を有する強化材の第 4の層を設けるステップ、および圧縮性材料の第5の層 を設けるステップ、から構成されている。

【0023】本発明の他の目的および付随する長所は、 付図に関連して考察する下記詳細説明を参照することに より容易に認識され、一層よく理解されるであろう。

[0024]

【発明の実施の形態】図2は、本発明によるエラストマ 接続子100の主要構造を示す。エラストマ接続子100は少 なくとも、強化材120の中に設置された一つ以上の導電 要素110を備えており、導電要素110も圧縮性材料130の 中に埋め込まれている。

【0025】図2は、2列の導電要素110を備えた2列 エラストマ接続子100の例により多数列エラストマ接続 子100の構造を説明している。エラストマ接続子100は、 圧縮性材料130の第1の層A、複数の埋め込み導電要素1 10の列を有する強化材120の第2の層B、圧縮性材料130 の第3の層C、今度も複数の埋め込み導電要素110の列 を有する強化材120の第4の層 D、および圧縮性材料13 0の第5の層Eの構成を備えている。

【0026】多数列エラストマ接続子100を設けるため には、層ABCの構成を数回繰り返すことができ、それ により、図2に示すような層ABCDEの構成により示 すように、圧縮性材料130の層がそれぞれ外側の層を与 えるとともに、複数の埋め込み導電要素110の列を有す る強化材120のそれぞれの層の間に設置される。

【0027】強化材120の中の一つ以上の導電要素110の 構成を、用途により、図2に示すような1列の個別導電 要素110や、一つの接合した導電要素110、または類似の もののようなどんな可能な順序にもすることができる。

【0028】圧縮性材料130を圧力の影響を受けて圧縮 可能に振る舞うどんな種類の材料としてもよい。これは 好適には、発泡体またはスポンジの中などへガスの吸蔵 により行なうことができる。圧縮性材料130は好適に は、シリコーン発泡体またはスポンジである。

【0029】強化材120は、導電要素110を埋め込んで強

一確保するのに適したどんな種類の材料でもよい。強化 材120は、単独導電要素110の間の良好な電気的絶縁をも 与えなければならない。強化材120は好適には、シリコ ーン材料、たとえば、シリコーンゴムである。

6

【0030】導電要素110は、たとえば、複数の、個別 の銅ファイバまたは銅ワイヤ、個別の金属ファイバまた は金属ワイヤ、またはカーボン線条から構成することが できる層ABCDEは必ずしも、図2に示すような「平 板」で構成とする必要はなく、用途により、必要に応じ てどんな所要形状にもすることができる。しかし、接続 させようとするPC板のほとんどは正に列状を成す接触 域を有するので、図2に示すような層ABCDEの「平 板」構成が最も普通であろう。

【0031】圧力が印加されると、圧縮性材料130は圧 縮され、その内部および外部の形状および横寸法を実質 的に維持するので、強化材120を実質的に圧縮させない ようにすることができ、強化材120はこの圧力の影響を 受けて「流れる」。しかし、エラストマ接続子100の内 部の圧縮性材料130および強化材120の本発明による構成 20 では、強化材120の、したがって導電要素110の圧力の影 響下での「流動」は極小にまで減少する。更に、複数の 個別層は、強化材120の隣接層が圧縮性材料130の1層に より分離されるような構成ABCDEをとるため、一つ の個別層BまたはDの、または強化材120の「流動」 は、強化材120の次の層には影響しないか、ほんのわず か影響するだけである。

【0032】エラストマ接続子100は好適には図3に示 したような構成で使用される。エラストマ接続子100 は、位置決め枠200に挿入され、互いにエラストマ接続 30 子100によ接続される第1のモジュール210と第2のモジ ュール220との間で圧縮される。位置決め枠200は、エラ ストマ接続子100を位置決めして中心に置き、且つモジ ュール210と220との間の熱接続をも確立することができ る。位置決め枠200はまた、過剰圧縮をさけるためエラ ストマ接続子100の圧縮可能な高さを制限する。

【0033】モジュール210と220との間に熱接続を確立 しようとする場合には、位置決め枠200は好適には、金 属枠であるか、または他の熱伝導度の高い材料から作ら れる。熱接続が必要でないか、または絶縁を確立しよう とする場合には、位置決め枠200を特定の用途に適する どんな種類の被覆金属またはプラスチック材料からでも 作ることができる。

【0034】位置決め枠200を(図3に示したように) 別ユニットにするか、または他の機能ユニットに、たと えば、モジュール210または220の一方に組み込むことが できる(たとえば、図6aおよび図6bを参照のこと。 それらの図では位置決め枠200はPC板400に組み込まれ ている)。位置決め枠200の内部寸法は、エラストマ接 続子100を位置決め枠200に精密に嵌め込むために、エラ 化材120の中の導電要素110の形状の安定性を一或る程度 50 ストマ接続子100の外部寸法と実質的に同じにするのが

8

よい。

【0035】図4aと図4bは、図3の構成を断面図で示している。図4aは、モジュール210および220を接続させる前の構成を示し、図4bは、第1のモジュール210と第2のモジュール220との間に接続が確立してからの構成を示している。

【0036】第1のモジュール210は、複数の接点210 A、210B、210C、210D、210E、210F、および210G を備えている。第2のモジュール220は、複数の接点220 A、220B、220C、220D、220E、220F、および220G を備えている。エラストマ接続子100は、たとえば図2に示したような構成に基づいて設置された複数の導電要素110A、110B、110C、110D、110E、110F、および110Gを備えている。接点210Aは導電要素110Aにより接点220Aと接触し、接点210Bは導電要素110Bにより接点220Bと接触するようになっており、以下同様である。

【0037】吸蔵ガスが圧縮性材料130に埋め込まれている場合には、これらの吸蔵は、圧力の影響を受けて崩壊し、したがって体積の物理的減少が生ずる。

【0038】モジュール210および220の接点間の接続を向上させるために、両者を押しつけない状態で、エラストマ接続子100の高さが位置決め枠200の高さより少なくともわずかに高くなるように選択する。(図3で矢印により示したように)両モジュールを互いに押しつけると、エラストマ接続子100の高さは、(図4bに示したように)位置決め枠200の高さと実質的に同じになる。好適実施例では、エラストマ接続子100の高さは、位置決め枠200の高さより約10%大きい。エラストマ接続子100と位置決め枠200との高さの差のため、導電要素110は、圧力の影響を受けてわずかに曲がり、導電要素110の頂部は、接触させようとするそれぞれの接点と係合し、またはそれぞれの接点内に食い込み、かくして気密接続が与えられる。しかし強化材120により導電要素110が不必要な程に曲がったり変形したりすることが防がれる。

【0039】モジュール210および220の好適に金属化された表面を位置決め枠200に押しつけることにより、モジュール210と220との間の熱接続度合いが向上し、余分な熱を、モジュールから、たとえば、取付けられたヒートシンクに流入させることができる。

【0040】好適実施例では、導電要素110の高さは、 強化材120の高さよりわずかに大きい。これにより導電 要素110を、接触させようとするそれぞれの接点に押し 当てると、押し当てにより導電要素にかかる力が増大 し、熱接続が向上する。

【0041】図4bに示したように、導電要素110を押し当ててからわずかに曲げ、安定な接続を構成することができる。しかし、圧縮性材料に埋め込まれているため、強化材120、およびしたがって導電要素110は、ほんのわずか「流れる」だけであるから、導電要素110の横方向

の位置は、圧力の影響を受けてもわずかに変わるだけで ある。

【0042】位置決め枠200の、したがってエラストマ接続子100の設置を、糊付け、ねじ止め、テーピングなどの当業者に周知の位置決め方法および手段によりおこなうことができる。図5は、位置決め枠200を位置決めするための構成の好適実施例を示す。位置決め枠200は、少なくとも二つの位置決めピン、すなわち第1の位置決めピン300および第2の位置決めピン310、により第2のモジュール220の上に位置決めされてその中心に置かれる。位置決めピン300および310は、第1および第2のモジュール210および220および位置決め枠200の対応する穴に挿入される。

【0043】図5は、第1および第2のモジュール210 および220を組立てて押しつける前は、位置決め枠200の上方にエラストマ接続子100がわずかに高くはみだしていることも示している。位置決めピン300および310は、第1および第2のモジュール210および220を接続させるための位置決め枠200のしたがってエラストマ接続子100の簡単かつ精密な位置決めおよび心出しを可能とする。

【0044】図6aおよび図6bは、図5の構成に基づ く装置を示しており、この装置は、電子的におよび/ま たは熱的に接続される複数の垂直に積み上げられたモジ ュール400、410、420、および430を備えている。この装 置を図6aに分解斜視図で、図6bに側面図で示してあ る。図6aおよび図6bの例では、モジュール400およ び430はPC板を表すが、モジュール410、および420 は、PC板400および430の間に随意に組入れることがで きる記憶モジュールを表している。エラストマ接続子10 30 0A、100B、および100Cは、それぞれ対応する位置決 め枠200A、200B、および200Cの内部に設置され、心 決めされている。位置決め枠200A、200B、および200 Cの対応する一つの中にあるエラス トマ接続子100A、 100B、および100Cの一つは、図6aおよび図6bから 明らかなように、モジュール400、410、420、および430 の隣接する側面間に位置決めされている。

【0045】図6aおよび図6bの例では、位置決め枠200Aは、熱伝導度の高い金属製の枠で、位置決め枠200Aのヒートシンクとして働くモジュール400の中に組み40込まれている。位置決め枠200A、200B、および200Cの位置決めおよび心出しは、第1の位置決めピン300および第2の位置決めピン310により行なわれる。圧力板440は、積み重ねモジュール400、410、420、および430、エラストマ接続子100A、100B、および100C、および位置決め枠200A、200B、および200Cに十分な垂直接触圧力を与えるために、位置決めピン300および310により更に位置決めされる。

【0046】エラストマ接続子100A、100B、および10 0Cはそれぞれ、モジュール400、410、420、および430 50 の対応する接触域(たとえば、図6aにおける接点配列4

10

50、460、および470; 更に他の接点配列が隣接モジュールの対応する側に設けられている)の間の電気的接続を与える。接触域を、たとえば、個別の接触パッドおよびヴァイア(たとえば、賃通穴、重点穴、または行き止まりのヴァイア等)から成る、当業者に周知などんな接触手段とすることもできる。

9

【0047】図6aおよび図6bに示したような構成をより多くのモジュールを接続する場合に拡張することができ、一般に機械的公差のような制約により数が制限されるだけであることを理解すべきである。構成全体は、接続させようとするモジュールの数に関係なく一つの単独機械的的組立体を表している。

【図面の簡単な説明】

【図1】従来技術によるエラストマ接続子10の主要構造を示す図である。

【図2】本発明によるエラストマ接続子100の主要構造を示す図である。

【図3】エラストマ接続子が位置決め枠に挿入されている状態の構成を示す図である。

【図4a】図3の構成を断面図で示してあり、モジュー

ルを接続させる前の構成を示す図である。

【図4b】図3の構成を断面図で示してあり、モジュール間の接続を確立してからの構成を示している図である。

【図5】位置決め枠を位置決めするための構成の好適実 施形態を示す図である。

【図6a】電子的におよび/または熱的に接続しようとする複数の垂直に積み重ねたモジュールから成る、図5の構成に基づく装置のモジュール配列の分解斜視図を示す。

【図6b】電子的におよび/または熱的に接続しようとする複数の垂直に積み重ねたモジュールから成る、図5の構成に基づく装置のモジュール配列の断面図を示す。

100 エラストマ接続子、

110 導電要素、

【符号の説明】

120 強化材、

130 圧縮性材料、

200 位置決め枠、

20 210、220 電子モジュール。

